

CLIPPEDIMAGE= JP360010756A

PAT-NO: JP360010756A

DOCUMENT IDENTIFIER: JP 60010756 A

TITLE: MANUFACTURE OF BEAM-LEAD TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: January 19, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAWAMAKI, AKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NEC CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP58119143

APPL-DATE: June 30, 1983

INT-CL (IPC): H01L021/92

US-CL-CURRENT: 29/827,438/464 ,438/FOR.380

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the reliability and production yield remarkably by a method wherein, when pellets are separated from a flat plate by a pellet adsorbing jig, any wax adhering to pellets is melted by heating to be removed using hot organic solvent in a heated receiver.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer 1 whereon specified beam-lead type element is formed is turned over to be bonded on a flat plate 4 made of quartz etc. using wax. Firstly resist pattern is formed on the backside of the wafer 1 and the wafer 1 is selectively etched by mixed acid solution utilizing the resist pattern as a mask to separate the wafer 1 into pellets 5.

Secondly the quartz plate 4 is heated by a hot-plate 7 to melt the wax 3 and the pellets 5 are separated from the quartz plate 4 using a pellet adsorbing jig 6. Finally was 13 adhering to the wiring side and backside of pellets 15 may be removed by means of spraying organic solvent preliminarily heated by a heater 11 with a cleaning receiver 14 also heated by a heater 12 and then the pellets 5 are arrayed on an arraying plate 22.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japic

10 日本国特許庁 (JP)
12 公開特許公報 (A)

其特許出願公開
昭60-10756

51 Int. Cl.
H 01 L 21/92

識別記号

庁内整理番号
7638 5F

43 公開 昭和60年(1985)1月19日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 3 頁)

54 ビームリード型半導体装置の製造方法

東京都港区芝五丁目33番1号日
本電気株式会社内

21 特 願 昭58-119143

出 願 人 日本電気株式会社

22 出 願 昭58(1983)6月30日

東京都港区芝五丁目33番1号

23 発 明 者 縄巻原雄

特 代 理 人 弁理士 内原晋

明 細 書

1. 発明の名称

ビームリード型半導体装置の製造方法

2. 特許請求の範囲

ビームリード型半導体装置の形成されたウェハ
ーを裏返してワックスで平板に貼り付ける工程と、
前記ウェハーを裏面から選択的にエッチング除去
してベレットに分離する工程と、前記ワックスを
溶しベレット吸着用器具にて前記平板から前記ベ
レットを分離する工程と、前記ベレットに付着し
ているワックスを、吸められた洗浄用受け皿内に
て、吸められた有機溶剤によってワックスを除去する
工程とを含むことを特徴とするビームリード型半
導体装置の製造方法。

3. 発明の追加事項

本発明はビームリード型半導体装置の製造方法
に関する。

従来ビームリード型半導体装置の製造方法は、
所望のビームリード型半導体素子の形成された半
導体基板の上面にワックスを塗布し石英板と貼り
合せし後、該半導体基板の裏面にレジストにてパ
ターンを形成し酸液槽で半導体ウエハーを選択的
にエッチング除去してベレットに分離し、前記
ベレット1個ずつ分離して再配列する為に100～
200℃の温度のホットプレート上でワックスを溶
しベレット吸着用器具にてベレットと石英板とを
分離後、半導体ベレットに付着ワックスを予め加
熱ヒーターで有機溶剤を吸められた有機溶剤をスプレ
ーガンで3～5分間吹付けて除去し別の配列板に
並べていた。

しかし上記従来のベレットハンドリング方法に
は、以下に述べるような欠点があった。

ベレットハンドリングする場合にベレットと石
英板とがワックスによって貼り合わさっており
このワックスを100～200℃の温度のホットプレ
ート上で石英板と吸めてワックスを溶かし、ベレ
ット吸着用器具にてベレットと石英板とを分離し、

半導体ペレットの配線面及び裏面に付着しているワックスを、50～100℃の温度範囲の加熱ヒーターにて予め有機溶剤を噴霧スプレーガンで吹付け時30～35秒間の有機溶剤を3～5秒間吹付けてワックスを除去し別の配列板に並べているがペレットサイズによってワックス洗浄に時間がかかりまたワックスが完全に取れない場合もあった。

ペレットの配線面及び裏面にワックスが残っていると、ペレットの信頼性及び歩留りを悪くし又ペレットサイズによってペレットハンドリングの洗浄時間を長くしたりするため作業能率を悪くする欠点を持っていた。

本発明は上記欠点を除去し半導体装置の信頼性及び製造歩留りを大幅に向上させることのできる半導体装置の製造方法を提供するものである。

本発明の特徴は、ビームリード型半導体素子の形成されたウェハを剥離してワックスで平版に貼り付けする工程と、前記ウェハを剥離から選択的にエッチング除去してペレットに分離する工

- 3 -

程とする。

次に図3に示すようにペレット15の配線面及び裏面に付着しているワックス13を50～100℃温度範囲の加熱ヒーター21によって予め有機溶剤と、洗浄用受皿18も加熱ヒーター19によって50～100℃の温度範囲で加熱し、スプレーガン20で吹付け時35～40秒間の有機溶剤を3～4秒間吹付けてワックスを除去した後、別の配列板22上にペレット15を配列する。^(第4図)

上記のように本発明方法によればペレットの配線面及び裏面に付着しているワックスを予め暖めた有機溶剤と洗浄用受皿も暖めることにより有機溶剤を蒸発してペレットに吹付ける事が出来るため、短時間でワックスが除去でき、しかもペレットにワックスが残ることなく、製造歩留り及び製品の信頼性が良くなり、しかもペレットサイズに関係なく短時間でペレットハンドリングが可能になる。

4. 図面の簡単な説明

- 5 -

程と、加熱によるワックスを剥しペレット剥離用器具にて前記半導体からペレットを分離する工程と、前記ペレットに付着しているワックスを、暖められた受皿内にて、暖めた有機溶剤にて除去する工程と、前記ペレットを配列する工程を含む半導体装置の製造方法にある。

以下本発明の最良の実施例を参照して本発明を詳細に説明する。

まず図1図に示すように、前記のビームリード型素子の形成された半導体ウェハ1を、前記ビームリード2が下になるように装填して、例えばスカイコートなどのワックス3を用いて石英などの平版4に貼り付ける。

次に前記半導体ウェハ1の裏面にレジストパターンを形成し、該パターンをマスクにして前記酸を用いてウェハを選択的にエッチング除去し、第2図に示すようにペレット5に分離する。次に100～200℃のホットプレート7の上で石英板4を暖めてワックス3を溶かしペレット剥離用具6を用いてペレット5を石英板4から分

- 4 -

第1図乃至第4図は本発明の実施例を説明する為の断面図である。

1……半導体ウェハ、2、12……ビームリード、3、13……ワックス、4……石英板、5、15……ペレット、6、16……ペレット剥離用具、7……ホットプレート、18……洗浄用受皿、19……洗浄用受皿の加熱ヒーター、20……スプレーガン、21……有機溶剤の加熱ヒーター、22……ガラス板である。

代理人 弁理士 内 原

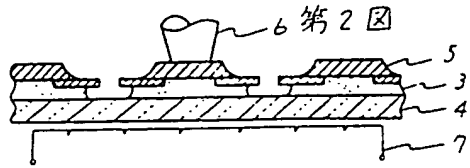


- 6 -

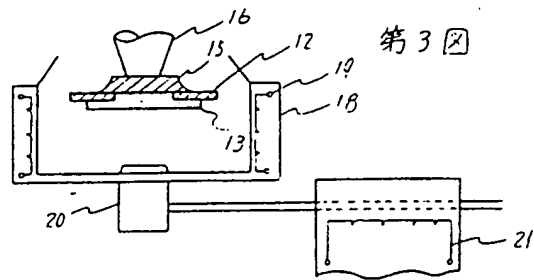
第1図



第2図



第3図



第4図

